

ICP/RIE - Oxford Plasmalab 100

E-mail	Telefone	Responsável
cioldin@unicamp.br	CCS: (019) 3521-7282 Sala Limpa: (019) 3521-7282	Frederico Cioldin
		Backup:

O descumprimento de qualquer uma das regras a seguir acarretará na suspensão temporária ou permanente do usuário.

Segurança

- Os gases utilizados no ICP são tóxicos, asfixiantes, inflamáveis e corrosivos. Em caso de emergência favor contatar o responsável.
- O usuário deve estar sempre presente na sala durante a operação.

Exigências

- Preencha o *logbook* com a receita utilizada e tempo de corrosão. Adicione qualquer informação relevante ou peculiaridades ocorridas ao longo do processo.
- O limite máximo de agendamento por dia é de 4 horas seguidas e 10 horas por semana por usuário.
- Um ciclo de limpeza deve ser realizado após cada corrosão respeitando os materiais:
 - Materiais orgânicos: O₂ e SF₆
 - Materiais inorgânicos baseados em Si: SF₆
 - É responsabilidade do usuário incluir o tempo de limpeza em seu período de agendamento;
- Checar a orientação do wafer:
 - Posicionar o chanfro à esquerda junto aos parafusos
- Após finalizar o uso do equipamento
 - Faça LOG OUT.
 - Informe ao técnico responsável do término do processo para que ele possa esvaziar a linha de gases perigosos (CH₄, H₂, Cl₂).

Restrições de materiais

- Metais com alta pressão de vapor não são permitidos. (Índio, Chumbo, TiO etc)
- Metais incompatíveis com processo CMOS (ouro, cobre, cromo, etc);
- Alguns metais são permitidos – favor verificar com o técnico responsável;
- Se for necessário corroer vidro com impurezas, contatar o responsável.
- Se utilizar um *wafer* de 4 polegadas completamente coberto com resite, favor remover de 5 à 10 mm das bordas. Isto é necessário para que o *wafer* possa ter um melhor contato térmico com seu porta *wafer*.
- Apenas *wafers* de 4 polegadas podem ser inseridos para corrosão ou usados como suporte para pequenas amostras (*carrier wafer*).
 - Cacos necessitam ser colados com pasta térmica em *carriers wafers* de 4 polegadas.
 - Verifique a espessura do *carrier wafer* antes de fazer qualquer corrosão para evitar que este se estilhe dentro da câmara.

Restrições de parâmetros

- Apenas executar receitas padrão.
- Não alterar qualquer uma das receitas sem aprovação prévia do técnico responsável
- Não alterar a temperatura das receitas.